

製品情報

IBM eServer BladeCenter LS20

- [概要](#)
- [仕様](#)
- [オプション](#)
- [技術情報](#)
- [保証・保守/サービス](#)

革新的なモジュール技術で、
際立つ高密度や可用性を実現



ハイライト

HPC(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング)分野などで必要とする高い能力を発揮するAMD Opteronプロセッサと高密度なスケールアップ環境を提供するIBM BladeCenterを組み合わせたIBM BladeCenter LS20が新たにラインアップ。

- 32ビット、64ビットに両対応したCPU、AMD Opteron プロセッサ 252(シングルコア)2.6GHz/デュアルコア AMD Opteron プロセッサ 270 2.0GHzを搭載
- 高速なPC3200 ECC DDRメモリーを採用し、薄型の筐体に最大で8GBまで搭載可能
- チップ・セットにはAMD 8131 & 8111を採用
- 7U※サイズのBladeCenterシャーシに最大で14枚まで搭載可能
- 64ビット時代のIAサーバーを牽引する新たなコンセプトXDA(Xpand Design Architecture)に基づいた設計

※ 1U=約44mm。

IBM BladeCenterの特長

BladeCenterは、以下のような数々の特長を備えたサーバー・システムです。

- **高性能**
BladeCenter LS20には、CPUにAMD Opteron 252 プロセッサ(シングルコア)2.6GHz、さらにデュアルコア AMD Opteron 270 プロセッサ 2GHz、HS40にはIntel® Xeon® プロセッサMP 2GHz/2.20GHz/3GHzを採用。
そしてチップ・セットにはAMD 8131 & 8111を採用。

また、64ビット・プロセッサ PowerPC 970 2.20GHzを2個、標準装備したBladeCenter JS20もラインアップ。多数のCPUを同時使用して演算処理を行うような、HPC分野やTier-2アプリケーション・サーバーをはじめオールラウンドに使用いただけるハイエンド指向なデザインを実現しています。

● 拡張性

BladeCenterは、業界標準の19インチ幅のラック・キャビネットに最適化された、高さ7Uの格納装置です。BladeCenter HS20/LS20/JS20なら14枚、HS40なら7枚まで搭載可能という、高い拡張性を持っています。また、イーサネットとファイバー・チャネル接続をサポートする4個のネットワーク・スイッチ・モジュール・ベイを装備。さらに、IBMのラック・ソリューション、NetBAY42 SR/ER、NetBAY25、NetBAY11をサポートします。

● 信頼性・可用性

BladeCenter HS20/LS20/JS20/HS40はホット・スワップに対応。メモリーにはChipkill機能を採用し、可用性の向上を果たします。

一方、BladeCenterにはホット・スワップ対応電源モジュールを装備し、堅牢な電源構成を実現。またホット・スワップ対応のブローワーの装備により、重要な位置の温度をモニターしながら、信頼性と優れた管理を実現するためのクーリングを提供します。

さらに、イーサネットとファイバー・チャネル・スイッチ・モジュールをサポートするためのホット・スワップ対応モジュール・ベイを装備しているほか、各ブレードをひとつのコンソールから管理可能にするインターフェースを提供。

障害箇所を容易に発見し、ダウン時間と管理コストを最小化する、LightPath診断とオンボード上の診断機能も装備しています。

● システム管理

BladeCenterは、高機能で、高度に統合化され、業界標準のスタンダードに基づいて使いやすさを追及したシステム管理ソリューション[IBM Director 4.1](#)による管理が可能です。

既存のエンタープライズまたはワークグループの管理環境で利用可能であり、インターネットを利用した物理的に分散したIT資産の効率的な管理と機密性のあるアクセスを可能にします。

これにより、システムのダウン時間の削減/IT管理者やエンド・ユーザーの生産性の向上/サービスとサポート・コストの削減などを果たし、管理コストの削減に貢献します。

※モデルによりChipkill機能未対応のメモリーが標準装備しているモデルもございます。

- [BladeCenter\(シャージ\)の詳細はこちら](#)

●

- [BladeCenter HS40の詳細はこちら](#)

インテルとの共同開発による最もスタンダードなブレード・サーバー

IBM BladeCenterは、インテル®社とIBMの共同開発により業界標準を念頭に産み出されたブレード・サーバーです。またMicrosoft®をはじめとする80社以上におよぶ協力各社との連携により、幅広くスタンダードなソリューションから、革新的なソリューションまでとりそろえることにも注力し、お客様のビジネス発展に貢献します。IBM BladeCenterは仕様を公開しているオープンなプラットフォームです。仕様公開の詳細につきましては、[こちら](#)から参照ください。

¹ このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。

² 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。

³ このカタログの情報は2005年5月25日現在のものです。

⁴ 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。

⁵ 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

- IBM、ServerGuide、ServeRAID、BladeCenterは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Intel、Xeonは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。
- 他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。

印刷時のご注意

Internet Explorerの「ツール」から「インターネット オプション」を選択します。次に、「詳細設定」タブの「背景の色とイメージを印刷する」にチェックを入れます。

製品情報

IBM eServer BladeCenter LS20

- 概要
- 仕様
- オプション
- 技術情報
- 保証・保守/サービス

製品仕様

モデル	BladeCenter LS20		
	8850-81J	8850-55J	
Bladeベイ. スペース	1 (最大14)		
同梱OS	-		
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	タイプ	AMD Opteron™ プロセッサ252(シングルコア)	デュアルコア AMD Opteron™ プロセッサ270
	内部周波数	2.6GHz	2.0GHz
	外部周波数	1GHz	
	2次キャッシュ	1MB (フルスピード)	2MB (フルスピード)※1
	SMPアップグレード※2	2.6GHz(シングルコア) (2Way)	2.0GHz(デュアルコア) (2Way)
チップ・セット	AMD 8131&8111(ChipKill機能付き)		
主記憶	標準容量	2GB PC-3200 ECC DDR SDRAM DIMM	1GB PC-3200 ECC DDR SDRAM DIMM
	DIMM装着状況	1GB × 2	512MB × 2※3
	DIMMソケット数(空き)	4(2)	
	最大容量	8GB※4	
ビデオ・サブシステム	ATI Radeon 7000M		
ビデオ・メモリー	16MB		
ディスク. インターフェイス	タイプ	Ultra320 SCSI (RAID 1機能付)	
	チャンネル数	1	
	内部コネクタ	2	
	外部コネクタ	0	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量※5	146.8GB※6	
	HDDベイ(空き)	2(2)	
ファイバーチャネル・カード	オプション		
ネットワーク. インターフェイス	デュアル 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(Broadcom 5704S)		
システム管理機能	標準装備		
エネルギー消費効率※7	I区分、0.020		II区分、0.016
サポートOS※8	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition、Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition、Microsoft Windows Server 2003 Web Edition、Red Hat Enterprise Linux AS 4 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux ES 4 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux WS 4 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux AS 4 (AMD64 and Intel EM64T)※9、Red Hat Enterprise Linux ES 4 (AMD64 and Intel EM64T)※9、Red Hat Enterprise Linux WS 4 (AMD64 and Intel EM64T)※9、Red Hat Enterprise Linux AS 3 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux ES 3 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux WS 3 (x86)※9、Red Hat Enterprise Linux AS 3 (AMD64 and Intel EM64T)※9、Red Hat Enterprise Linux ES 3 (AMD64 and		

	Intel EM64T)※9、Red Hat Enterprise Linux WS 3 (AMD64 and Intel EM64T)※9、SUSE LINUX Enterprise Server 9※9、SUSE LINUX Enterprise Server 9 for AMD64 and Intel EM64T※9、VMware ESX Server 2.5
付属品	インストールガイド、ドキュメントCDパック
保証期間※10	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス(8時間×週5日/CRU)

- ※1 2次キャッシュ:1MBを内蔵。(コア当たり。合計2MBの2次キャッシュ)
- ※2 SMPアップグレードとして同一周波数、同一キャッシュ・サイズのプロセッサを最大2個まで使用可能。
- ※3 標準で搭載されている512MBメモリーは、Chipkill未対応になります。
- ※4 2GBメモリーを4つ装着した場合。(標準で装着されているメモリーを取り外し、2GBメモリーに付け替える必要があります。)
- ※5 ハードドライブ容量に関しては、MBは100万バイトを表し、GBは10億バイトを表します。ユーザーがアクセスできる総容量は作業環境によって変化します。
- ※6 73.4GBのスリム・ハードディスクを2台装着した場合。
- ※7 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
- ※8 これらのOSはサポートOSであり、使用にあたっては別途購入の必要があります。
- ※9 基本OS部分のみ。
- ※10 詳しい保証の内容については次のURLをご参照ください。
保証・保守/サービス:

¹ このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。

² 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。

³ このカタログの情報は2005年5月25日現在のものです。

⁴ 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。

⁵ 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

- IBM、ServerGuide、ServeRAID、BladeCenterは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Microsoft、Windows、Windows NTおよびWindowsロゴは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Intel、Xeonは、Intel Corporationの米国およびその他の国における商標。
- Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。
- 他の会社名、製品名、およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。